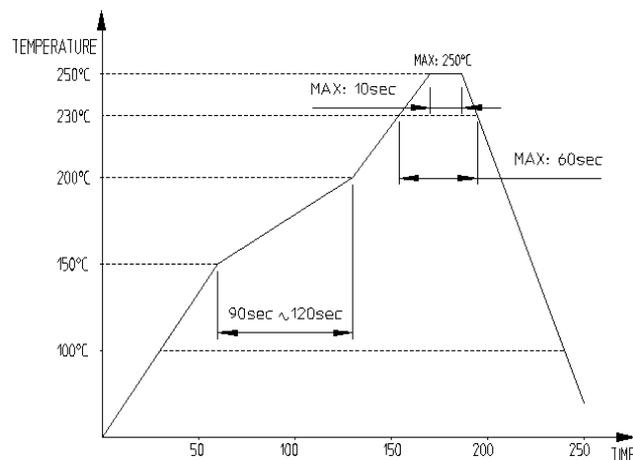


訂正	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	訂正	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	1	Revised Drawing	PYB	LHJ	21.12.15	△					
△						△					
使用規格			Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.1 Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document Revision 2.1b								
定格	電流	1.50A Max. (電源用) (i.e. A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12) 1.25A Max. VCON(i.e. B5), 0.25A (その他)									
	電圧	48V AC/DC									
使用温度範囲		-40℃ ~ +105℃(温度上昇含め), 95% RH MAX.(結露無いこと)									
保存温度範囲		-10℃ ~ +60℃(梱包状態), 15% ~ 70% RH									
Para.	項目	試験方法				規格			QT	AT	
1	外観、構造、仕上げ	EIA 364-18 目視にて確認する。				物理的な破損が無いこと。			○	○	
電氣的性能											
2	接触抵抗	EIA 364-23 100mAで20mVの最大開回路で測定します。 (DCまたは1000Hz)。 4線測定が必要であり、PCB終端の抵抗は測定値から差し引かれます。				初期 40mΩ以下 試験後、50mΩ以下			○	-	
3	耐電圧	EIA 364-20 ① 未嵌合状態でB方法で測定する。 ② AC100Vの電圧を1分間印加する。				せん絡、絶縁破壊が無いこと。			○	-	
4	絶縁抵抗	EIA 364-21 嵌合/未嵌合状態でDC 500Vで測定する。				100MΩ以上			○	-	
5	温度上昇	IEC60529, EIA-364-70, method B : 6.0 Aの電流をVBUSピン (つまり、ピンA4、A9、B4、およびB9) にまとめて適用し、1.25 AをVconnピン (つまり、プラグコネクタのB5) に適用し、対応するGNDを通るリターンパスを使用します。ピン (つまり、ピンA1、A12、B1、およびB12) 。 0.25 Aの最小電流も、他のすべての接点に個別に適用する必要があります。				温度上昇は30℃を超えてはならない			○	-	
機械的性能											
6	挿入力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。				初期 & 試験後：5N ~ 20N (パージンプラグ使用)			○	-	
7	抜去力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。				初期：8N ~ 20N 試験後：6N ~ 20N (パージンプラグ使用)			○	-	
8	繰り返し動作	EIA 364-09 10,000回の抜き差しを行う。 -機械操作：500±50回/hr -嵌合ストローク：2.75mm -挿入、抜去力は、最大速度で測定した12.5mm/分				物理的な破損が無いこと。			○	-	
参 考					DRAFT	DESIGN	CHECK	APPROVAL	RELEASE		
					Y.B.PARK	Y.B.PARK	H.J.LEE	H.J.LEE			
					21.09.02	21.09.02	21.09.02	21.09.02			
NOTE) QT : QUALIFICATION TEST, AT : ASSURANCE TEST, O : Applicable Test											
DWG NO				CL NO				PART NO			
JLC4-633131				CL 6246-0002-0				CX90BW-16P			
						製品規格表				1/3	

Para.	項目	試験方法	規格	QT	AT
環境的性能					
9	ランダム振動	EIA 364-28 試験条件 VII, 試験文字 D 周波数 20-500 Hzで、 3軸方向 各15分 振動を加える。	物理的な破損が無いこと。 1us以上の電氣的瞬断がないこと。	○	-
10	温度寿命	EIA 364-17, A方法 105℃に120時間放置する。	物理的な破損が無いこと。	○	-
11	温湿度サイクル	EIA 364-31 25℃±3℃から80%±3%RHで1時間 65℃±3℃から50%±3%RHで1時間 24サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	○	-
12	温度サイクル	EIA 364-32, 試験条件 I -55℃で+105℃10サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	○	-
13	はんだ付け性	EIA 364-52 はんだ付け部をはんだ槽245℃±5℃中に5秒間浸漬させる。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで濡れていること。	○	-
14	塩水噴霧	EIA 364-26 濃度5%の塩水、試験温度35℃中に48時間放置する。	コネクタの作動に影響を与える腐食が無いこと。	○	-
15	高温と湿度	EIA-364-31 高温85℃/ 85%RHで120時間。	物理的な損傷はありません。 パフォーマンスに変更はありません	○	-
16	混合流動ガス	EIA 364-65 測定環境30℃/ 70%RH CL210±3ppb、No2200±50ppb、 H2S10±5ppb、SO2100±20ppb サンプルの半分を1/3日間交配させた後、2/3日間交配させないでください。残りは、完全に7日間交配させて暴露します。 テスト期間。	影響を与える腐食はありません コネクタ操作に。	○	-
17	IPX4	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。 期間：少なくとも10分。 水量：10L /分 圧力：50~150 Kpa	水漏れはありません。	○	-
18	リフローヒート	リフロー条件[図-1] ピーク250℃マックス10秒基準で 2回リフローする。	絶縁座に異常ないこと。 プリスター等の外観異常ないこと。	○	-

参考



[Fig1]. 推奨リフロープロファイル

NOTE) QT : QUALIFICATION TEST, AT : ASSURANCE TEST, O : Applicable Test

DWG NO	CL NO	PART NO
JLC4-633131	CL 6246-0002-0	CX90BW-16P

Qualification Test Sequence Table

Para.	試験項目	試験グループ									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	外観、構造、仕上げ	1, 6	1, 14	1, 6	1, 6	1, 7	1, 3	1, 6	1, 7	1, 6	1, 4
2	接触抵抗	3, 5	3, 13	3, 5	3, 5	3, 6		3, 5	3, 6	3, 5	
3	耐電圧		4, 12								
4	絶縁抵抗		5, 11								
5	温度上昇										3
6	挿入力		6, 10								
7	抜去力		7, 9								
8	繰り返し動作		8								
9	ランダム振動	4									
10	温度寿命			4							
11	温湿度サイクル				4						
12	温度サイクル					4					
13	はんだ付け性						2				
14	塩水噴霧							4			
15	高温と湿度								4		
16	混合流動ガス									4	
17	IPX4					5			5		
18	リフローヒート	2	2	2	2	2		2	2	2	2

参 考

1) 上記表の数字は各試験別試験する順番を表示する。

NOTE) QT : QUALIFICATION TEST, AT : ASSURANCE TEST, O : Applicable Test

DWG NO JLC4-633131	CL NO CL 6246-0002-0	PART NO CX90BW-16P
------------------------------	--------------------------------	------------------------------